

Thermaltake Armor Revo Gene Snow Edition



LINK (<https://www.nexthardware.com/recensioni/case/740/thermaltake-armor-revo-gene-snow-edition.htm>)

L'Armor Revo torna alla ribalta, ma in versione ridotta.

L'Armor Revo Gene è al passo con i tempi anche per quanto riguarda le connessioni; sono presenti, infatti, due USB 3.0 sull'I/O Panel ed un sistema Hot Swap per HDD e SSD sia da 2,5" che da 3,5", come ormai consuetudine per i prodotti di fascia alta.

Ma andiamo ora ad elencare le varie versioni disponibili sul mercato e le caratteristiche di questo modello.

Versioni disponibili

- > Thermaltake Armor Revo Gene (VO800M1W2N)
- > Thermaltake Armor Revo Gene Snow Edition (VO800M6W2N)

Caratteristiche principali

- > Finestra in Plexiglass sul pannello laterale.
- > Supporto per un'eventuale installazione di sistemi watercooling.
- > Sistema di fissaggio delle periferiche e dei drive ottici tool-less.
- > Connessioni USB 3.0 sul pannello frontale tramite plug a 20 pin.
- > Cable Management agevolato grazie alle speciali asole presenti sul vassoio della motherboard.

Scheda Tecnica

Marca	Thermaltake (Taiwan)
Modello	Armor Revo Gene (Snow Edition)
Fattore di forma	Mid Tower
Dimensioni (mm)	510 (H) x 252 (W) x 550 (D)
Peso	7,8 kg
Materiale	Struttura in SECC con parti in plastica ABS
Supporto Motherboard	↔ Standard ATX e microATX
Alloggiamenti Drive presenti	Esterni: 4 x 5.25" - 1 x 3.5" Hot Swap: 1 x 2.5" o 3.5"
Sistema di raffreddamento (ventole)	Frontale: 1x200mm LED Blu (600rpm,13dBA) Top:↔ 1x200 (600rpm, 13dBA) Inferiore: 1x120 (opzionale)
Slot di espansione	7
Connessioni I/O frontali	USB 3.0↔ x 2 Audio x 1
Altezza massima dissipatore CPU	175 mm
Lunghezza massima VGA	315 mm

1. Packaging & Bundle

1. Packaging & Bundle



Su uno dei due lati corti troviamo le caratteristiche principali del prodotto in varie lingue, tra cui l'italiano, mentre su quello opposto sono presenti il logo, un'ulteriore immagine ed alcuni dettagli aggiuntivi, come il peso a vuoto e con hardware installato.



All'interno del bundle, nello specifico, troviamo:

- Un manuale contenente le istruzioni per l'assemblaggio in ben 12 lingue, tra cui anche l'italiano.
- Una Brochure che spiega le Condizioni di Garanzia del Prodotto.
- Cinque fascette con sistema di bloccaggio a sfera riutilizzabili per ottimizzare il cablaggio.
- Uno speaker audio.

2. Out of the box

2. Out of the box



Il Thermaltake Armor Revo Gene, estratto dalla confezione, si presenta protetto da un imballo di polistirolo e coperto da un rivestimento in tessuto per evitare eventuali danni in fase di trasporto. La finestra in Plexiglass è inoltre ricoperta da una pellicola protettiva che ne garantisce l'integrità .



I pannelli sono realizzati in acciaio SECC con una verniciatura di colore bianco opaco.

Sul pannello sinistro è presente la finestra in Plexiglass che mette in risalto la parte superiore della scheda madre.

In basso troviamo la predisposizione per una generosa ventola da 200mm, opzionale, deputata al raffreddamento delle VGA.

Sulla parte alta, in prossimità del frontale, è presente un apposito gancio per il posizionamento delle cuffie, che vedremo in dettaglio nel prosieguo della recensione.

Il pannello destro invece, non offre alcuna peculiarità , eccezion fatta per una bombatura che permette di avere più spazio tra la struttura e lo stesso e quindi agevolare il cable management, occultando in modo rapido ed ordinato i vari cavi.



Le immagini con un'angolazione di 45° mettono in evidenza il design accattivante e la solidità di questo case gaming, che fa della speciale "armatura" uno dei suoi punti di forza.

3. Esterno - Parte prima

3. Esterno - Parte prima

Vista superiore ed inferiore



La superficie d'appoggio è costituita da quattro piedini in plastica che, oltre ad assorbire le vibrazioni, rialzano il case di circa 2,5cm, permettendo alla ventola dell'alimentatore un migliore pescaggio dell'aria esterna.

Vista frontale e posteriore



La parte frontale del Thermaltake Armor Revo Gene, realizzata in ABS bianco opaco, presenta dei bezel in mesh metallica, facilmente rimovibili premendone le estremità verso l'interno.

In alto possiamo osservare il logo alato, che verrà illuminato dal LED posto internamente per segnalare lo stato di accensione del sistema.

Ai due lati sono presenti le alette in alluminio, apribili e rimovibili mediante un incastro in plastica, che proteggono i quattro bay per l'alloggiamento delle unità da 5,25" e, più in basso, il bay per periferiche da 3,5".

Sulla estremità inferiore fa bella mostra di sé il logo Thermaltake pregevolmente cromato.

Posteriormente sono presenti, partendo dall'alto, tre asole passatubo, dotate di guarnizione in gomma, dedicate al passaggio di tubi per impianti di watercooling esterni.

Immediatamente sotto, sulla destra, è situata la griglia di areazione per la ventola da 120mm inclusa in bundle mentre, a sinistra, vi è l'apertura atta ad ospitare l'I/O Shield della mainboard.

Nella parte centrale sono presenti sette slot di espansione, coperti da frame metallici forati, in modo tale da favorire il ricircolo d'aria.

L'alloggiamento per l'alimentatore si trova in basso, seguendo le attuali tendenze progettuali.

4. Esterno - Parte seconda

4. Esterno - Parte seconda

Frontale



Come si può notare dalle immagini soprastanti, la parte anteriore è completamente rimovibile.

L'installazione delle periferiche da 3.5 e 5.25" però, non richiede che questa operazione venga svolta, data la presenza di bezel facilmente estraibili tramite clip.

La sola motivazione che potrebbe spingere ad estrarre il pannello frontale, è quella di voler pulire il filtro antipolvere a protezione ventola anteriore da 200mm.



è possibile, inoltre, rimuovere entrambe le alette laterali in alluminio, esercitando una leggera pressione sui relativi supporti in plastica, operazione alquanto inutile.

Pannello di I/O



Nella foto a destra possiamo osservare un Hard Disk da 3,5" nel comodo e pratico dock.

Supporto per le cuffie



Tenendo conto di questo specifico aspetto, Thermaltake ha deciso di includere, sul pannello sinistro dell'Armor Revo Gene, uno speciale stand in modo da poterle riporre in assoluta sicurezza su di esso.

5. Interno

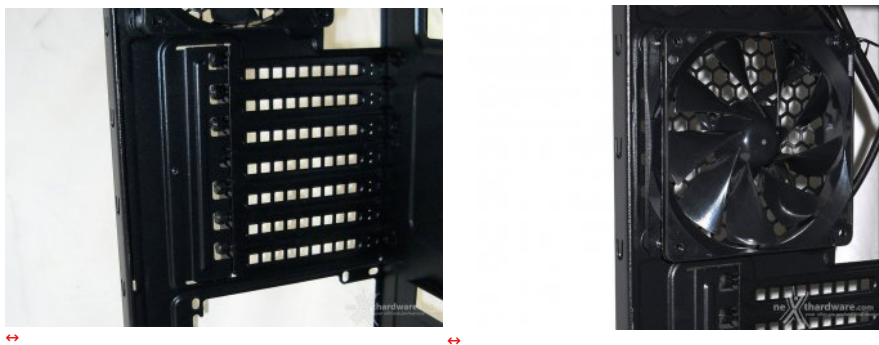
5. Interno



Una volta estratti i pannelli laterali, possiamo osservare l'interno del Thermaltake Armor Revo Gene caratterizzato da una finitura nera e ampi spazi di manovra. I quattro fori ellissoidali, posti sulle estremità del vassoio interno, agevolano in maniera significativa il routing dei cavi preservandoli da tagli e sfilacciature grazie alla presenza di guarnizioni in gomma.

In linea con gli attuali standard, non poteva mancare un ampio scasso in corrispondenza del socket della CPU per un'agevole installazione e manutenzione di dissipatori o waterblock dotati di backplate, senza essere costretti ogni volta a smontare la scheda madre.

Lo spazio nativo tra la parte posteriore del vassoio ed il pannello non è molto ampio, ma è compensato dalla bombatura di quest'ultimo, permettendoci di alloggiare i cavi in modo piuttosto ordinato.



La foto di sinistra mostra i sette slot per le schede di espansione dotate di viti con testa zigrinata, che permettono il montaggio tool less delle periferiche.



In alto possiamo osservare il robusto supporto di rinforzo che copre gli slot per le schede di espansione.

Supporti periferiche



Il comodo sistema di blocco tool less per le periferiche da 5.25".



Un primo piano del sistema di alloggiamento dei drive da 2.5" e 3.5".



Il cestello per le unità di storage non è rimovibile e prevede la presenza di quattro slitte in cui è possibile installare tramite viti i drive da 2.5" ed in modalità tool less quelli da 3.5".



La ventola da 200mm in dotazione.



Sul top del case è posizionata una poderosa ventola di serie da 200mm in estrazione che, qualora si volesse installare un radiatore biventola, è possibile eliminare in favore di una coppia di dispositivi da 120mm.

Supporto alimentatore



Una vista del vano dedicato all'alloggiamento dell'unità di alimentazione.



Il vano dell'alimentatore, purtroppo sprovvisto di gommini antivibrazioni, è dotato di un'ampia griglia, divisa in due parti, provvista di un unico filtro antipolvere facilmente rimovibile per le normali operazioni di pulizia.

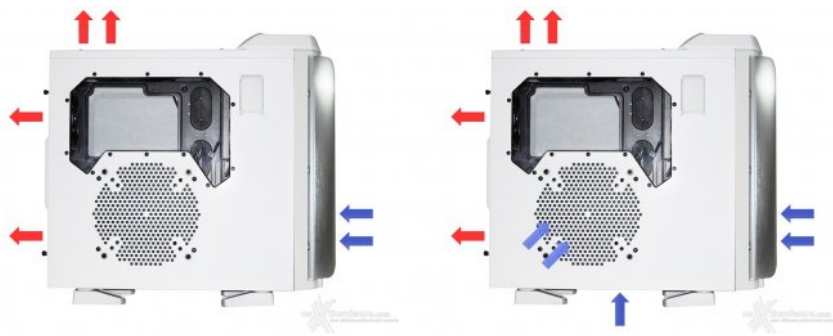
A destra possiamo osservare la predisposizione per una ventola aggiuntiva da 120mm.

6. Raffreddamento

6. Raffreddamento

Il Thermaltake Armor Revo Gene, essendo un case a chiara vocazione gaming, è dotato di ben tre ventole per il raffreddamento, una soluzione ottimale anche per i gamers più esigenti che montano sistemi di elevata potenza e ne fanno un uso intenso anche nel periodo estivo.

- Frontale: 1x200mm LED Blu (600 rpm, 13dBA)
- Posteriore: 1x120mm (1000 rpm, 16dBA)
- Top: 1x200mm (600 rpm, 13dBA)



↔ Aerazione standard

↔ Aerazione con ventole opzionali

Come si può vedere dalle immagini in alto, il raffreddamento è il punto forte di questo case che, con spazi ampi e ventole grandi e silenziose, riesce a smaltire efficacemente il calore prodotto al suo interno. Con l'aggiunta di una terza ventola da 200mm sul pannello laterale e un'altra da 120mm sul fondo, nella predisposizione adiacente all'alimentatore, l'Armor Revo Gene riesce ad ottenere un aumento consistente della propria capacità di raffreddamento. Si consiglia caldamente di aggiungere la ventole laterale nel caso si utilizzi un sistema multi VGA.

Ventola posteriore



Modello	TT-1225
Dimensioni	120x120x25mm
Tensione	↔ 12V
Assorbimento	↔ 0.30A
Velocità di rotazione	1000 rpm
Rumorosità	↔ 16dBA
↔ LED	assenti

Ventola anteriore



Modello	TT-2020
Dimensioni	200x200x20 mm
Tensione	12V
Assorbimento	0.42A
Velocità di rotazione	600 rpm
Rumorosità	↔ 13dBA
LED	↔ Blu

Ventola superiore



Modello	TT-2030
Dimensioni	↔ 200x200x30 mm
Tensione	↔ 12V
Assorbimento	↔ 0.42A
Velocità di rotazione	600 rpm
Rumorosità	13dBA
LED	↔ assenti

7. Montaggio componenti

7. Montaggio componenti

Per l'assemblaggio di prova della nostra macchina abbiamo utilizzato un alimentatore modulare Thermaltake Toughpower XT Platinum, una singola scheda video ed un dissipatore da 170mm.



A sinistra possiamo osservare i pratici bezel che ricoprono i vani da 5.25" e quello da 3.5", immediati da smontare grazie alla pressione verso l'interno delle due clip laterali.

A destra vediamo l'inserimento del cassetto all'interno del cestello; una volta spinto sino in fondo, sarà bloccato saldamente nelle guide grazie all'azionamento delle clip poste sulla parte esterna.



Successivamente, sono state montate le periferiche di archiviazione, l'alimentatore modulare e la scheda video.

Il lavoro è stato completato in pochi minuti, grazie all'ampio spazio di lavoro offerto dall'Armor Revo Gene.

Le asole passacavi si sono rivelate di estrema importanza consentendoci di occultare i cavi dietro al vassoio e di disporli in modo ordinato, grazie anche all'utilizzo delle comode fascette con sistema di bloccaggio a sfera presenti in bundle.



Una nota di merito allo stupendo impatto visivo dell'Armor Revo Gene Snow Edition, grazie alla combinazione tra il bianco della struttura, l'alluminio delle alette frontali ed il blu dei LED della ventola anteriore.



In alto possiamo ammirare il magnifico logo alato, illuminato posteriormente da un LED ad intermittenza che segnala l'attività del sistema.

8. Conclusioni

8. Conclusioni

L'Armor Revo Gene, grazie alla cura dei particolari posta in essere da Thermaltake, è riuscito a soddisfare tutte le nostre aspettative, confermandosi un ottimo case per il gaming.

Il design è aggressivo quel tanto che basta e risulta piacevole alla vista, specialmente nella versione Snow Edition caratterizzata da una pregevole finitura bianco opaco.

I materiali impiegati sono di buona qualità e gli ampi spazi di lavoro offerti permettono un cable management pulito e ordinato, consentendo un rapido assemblaggio anche nel caso si vogliano installare configurazioni più complesse rispetto a quella da noi utilizzata, che prevedono, ad esempio, due VGA in SLI o CrossFire.

Ottimo il sistema di aerazione che prevede tre ventole di serie efficienti ed estremamente silenziose, assolutamente adatte a placare i bollenti spiriti dei componenti di ultima generazione.

Il pannello delle connessioni, posto sul top del case, risulta completo e, grazie alla presenza di un cavo USB SuperSpeed con plug a 20 pin, consente di collegare le due porte USB 3.0 direttamente all'header della scheda madre.

Per quanto riguarda la portabilità, invece, i circa 10 kg del case con hardware installato si fanno sentire durante il trasporto e, data l'assenza di maniglioni, è preferibile spostarlo il meno possibile.

Il prezzo su strada è di circa 150 €, a nostro avviso in linea per qualità e funzionalità offerte, anche se troppo vicino, forse, a quello del fratello maggiore.



Pro

- Design
- Qualità dei materiali
- Efficiente sistema di aerazione
- Ottima gestione degli spazi interni
- Dock Hot Swap
-

Contro

- Nulla da rilevare

↔

Si ringrazia Thermaltake Italia per il sample inviato in recensione.



nexthardware.com